

Title (en)

ALLOY OF GOLD AND COPPER, METHOD FOR PREPARING SAME AND USE THEREOF

Title (de)

LEGIERUNG AUF GOLD-KUPFER-BASIS, IHR HERSTELLUNGSVERFAHREN UND IHRE VERWENDUNG

Title (fr)

ALLIAGE A BASE D'OR ET DE CUIVRE, SON PROCEDE DE PREPARATION ET SON UTILISATION

Publication

**EP 3527678 A1 20190821 (FR)**

Application

**EP 18156884 A 20180215**

Priority

EP 18156884 A 20180215

Abstract (en)

[origin: WO2019158481A1] The present invention relates to an alloy comprising: - 75% to 77.5% gold, - 10% to 24.0% copper, - 0.1% to 10.0% silver, - 0.1% to 1.1% palladium, - 0.1% to 2.0% tin, - 2% or less titanium, - 0.2% or less of at least one element selected from ruthenium, rhenium, iron, iridium, cobalt, vanadium, molybdenum and mixtures thereof. The present invention also relates to the use of said alloy in the fields of jewellery and watchmaking.

Abstract (fr)

La présente invention concerne un alliage comprenant :- 75 % à 77,5 % d'or,- 10 % à 24,0 % de cuivre,- 0,1 % à 10,0 % d'argent,- 0,1 % à 1,1 % de palladium,- 0,1 % à 2,0 % d'étain,- 2 % ou moins de titane,- 0,2 % ou moins d'au moins un élément choisi parmi le ruthénium, le rhénium, le fer, l'iridium, le cobalt, le vanadium, le molybdène et leurs mélanges.La présente invention concerne également l'utilisation de cet alliage dans les domaines de la joaillerie et de l'horlogerie.

IPC 8 full level

**C22C 5/02** (2006.01); **A44C 27/00** (2006.01); **G04B 37/22** (2006.01)

CPC (source: EP)

**C22C 5/02** (2013.01); **G04B 37/22** (2013.01)

Citation (applicant)

- JP H10245646 A 19980914 - SEIKO EPSON CORP
- EP 2776597 A1 20140917 - SWATCH GROUP RES & DEV LTD [CH]
- WO 2015038636 A1 20150319 - APPLE INC [US]

Citation (search report)

- [A] US 2014305164 A1 20141016 - LAUPER STÉPHANE [CH], et al
- [AD] WO 2015038636 A1 20150319 - APPLE INC [US]
- [A] GB 2447620 A 20080924 - CORBRIDGE SARAH J [GB]
- [A] JP 2008308757 A 20081225 - RAAPI SU KK
- [A] US 5919320 A 19990706 - AGARWAL DWARIKA P [US], et al
- [A] WO 2015173790 A1 20151119 - REPL PROGOLD S P A [IT]

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

DOCDB simple family (publication)

**EP 3527678 A1 20190821; EP 3527678 B1 20210602; WO 2019158481 A1 20190822**

DOCDB simple family (application)

**EP 18156884 A 20180215; EP 2019053325 W 20190211**